



2026年3月25日～27日に開催されます「SEMICON China 2026」に出展いたします
皆様のご来場お待ちしております。

【出展内容】

(新機種 パネルレベルパッケージ対応 PLP-700)

サイズが最大 700 mm×700 mmに対応するパネルレベルパッケージ用の最新設備(PLP-700)のパネル展示を中心に、半導体設備の提案をいたします。

*PLP-700 詳細情報は SEMICON China2026 会場にて
(会場)

- ・東栄電子有限公司ブース No. N5-104
- ・TOYO ADTEC ブース No. N2-2760
- ・KROMAX ブース No. N1-1008
- ・TOTECH SHANGHAI ブース No. N1-1242

(新機種 12 インチ用マルチワイヤーソー MWS-SiC12F)

大口径インゴット (Φ 12 インチ対応※最大 14 インチまで) 切断用の最新型マルチワイヤーソーMWS-SiC12F をパネル展示いたします。

*MWS-SiC12F 詳細情報は SEMICON China2026 会場にて
(会場)

- ・東栄電子有限公司ブース No. N5-104

(SEMICON China2026 公式サイト)

<https://www.semiconchina.org/>

